

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2026-010

浙江中晶科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本129,619,000股扣除公司回购专户的股份(回购专户持有公司股份数量为400,000股)为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中晶科技	股票代码	003026
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李志萍	叶荣	
办公地址	浙江省湖州市长兴县太湖街道陆汇路 59 号	浙江省湖州市长兴县太湖街道陆汇路 59 号	
传真	0572-6508782	0572-6508782	
电话	0572-6508789	0572-6508789	

电子信箱	ir@mtcn.net	ir@mtcn.net
------	-------------	-------------

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司主营业务为半导体单晶硅材料及其制品的研发、生产和销售。公司当前主营业务的经营布局如下：半导体硅单晶生长及晶棒加工以宁夏中晶为主要生产基地；半导体单晶硅片加工以浙江中晶与西安中晶为核心，该业务在我国半导体分立器件用硅单晶材料的硅研磨片细分领域占据领先的市场地位；《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》以中晶新材料为实施主体，抛光硅片产品将会成为公司未来重要主营产品之一，当前处于产线扩增、产量提升和客户批量认证过程中，客户群体增加，产品种类丰富、规格全，能够较好满足下游客户不同产品需求；江苏皋鑫在现有高频高压半导体芯片及器件产品基础上，推动新项目、新产品投入运行。新厂房设备安装调试基本完成，目前处于新产线产品认证过程中。随着新项目推进，未来公司将持续加大研发投入和新产品导入，进一步丰富产品结构。公司作为专业的高品质半导体硅材料和半导体功率芯片及器件制造商，是国家高新技术企业、全国半导体设备和材料标准化技术委员会成员单位，是浙江省半导体行业协会、中国电子材料行业协会会员单位，是中国电子材料行业协会半导体材料分会第六届理事会理事单位，在半导体硅材料和半导体功率芯片及器件制造领域拥有多项核心技术和专利。公司核心管理团队长期致力于半导体硅材料和半导体功率芯片及器件的研发与生产，在产品研发、生产工艺、质量控制等方面拥有完善的技术储备和强大的技术创新能力。

（二）主要产品及其用途

公司是一家专业从事半导体单晶硅材料及其制品研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司产品涵盖半导体单晶硅棒、研磨片、化腐片、抛光片、半导体功率芯片及器件等。公司半导体单晶硅片产品是制造半导体芯片的重要基础材料，是支撑半导体产业发展最重要、应用最广泛的基础功能性材料，主要应用于各类功率二极管、功率晶体管、大功率整流器、晶闸管、过压/过流保护器件等功率半导体器件，以及部分传感器、光电子器件、肖特基、FRD、MOS器件的制造。公司的半导体功率芯片及器件作为各类电子设备的关键零部件，广泛应用于微波炉、激光打印机、复印机、CRT/TV显示器、X光机及大型医疗设备、负离子发生器、空气净化、激光切割、高压静电喷涂、工业静电设备、油田设备、高压电源等领域。公司具有从晶棒端到器件芯片端的一体化产业链制造模式，不断为客户提供高品质、高效率、全规格的产品服务，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。

（三）所处行业基本情况

受消费电子温和复苏、汽车电子及人工智能快速发展影响，2025年以来半导体行业总体表现出良好的复苏态势，重回上升通道。同时在半导体国产化替代带动下，随着国内产业链布局逐步完善，国内半导体海外需求不断转移至国内，各细分行业保持增长态势；全球产业竞争格局相对稳定，我国已具备较完整的半导体产业链布局，产业链的自主可控能力提升，各环节均取得一定技术成果。根据美国半导体行业协会（SIA）发布声明，2025年全球半导体市场销售额达到7,917亿美元，

较2024年6,305亿美元的总额增长了25.6%。

（四）公司所处的行业地位情况

半导体硅片是生产集成电路、分立器件、功率器件等半导体产品的关键材料，是半导体产业链中不可或缺的基础性环节。公司自成立以来始终专注于半导体单晶硅材料及其制品的研发、生产和销售，具有完整的生产供应链。凭借长期积累的技术优势、产能优势和质量优势，公司已在国内分立器件用单晶硅棒、研磨硅片以及半导体功率芯片及器件领域占据领先的市场地位。未来公司将在巩固现有行业地位的前提下，加快推进抛光硅片增产上量、芯片项目建设发展，进一步完善产品结构，提升公司创新能力和核心竞争力，为行业的高质量发展提供有力的支撑。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	1,253,642,744.90	1,284,632,310.66	-2.41%	1,384,123,368.58
归属于上市公司股东的净资产	667,392,845.00	648,763,275.84	2.87%	688,681,252.38
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	428,917,134.52	422,567,489.89	1.50%	348,495,266.97
归属于上市公司股东的净利润	43,075,871.58	22,772,176.63	89.16%	-34,065,701.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,651,924.21	19,539,098.96	97.82%	-37,053,623.97
经营活动产生的现金流量净额	51,446,770.69	41,886,710.06	22.82%	56,073,495.51
基本每股收益（元/股）	0.33	0.18	83.33%	-0.34
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.18	83.33%	-0.34
加权平均净资产收益率	6.56%	3.39%	3.17%	-4.80%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	99,981,574.59	117,212,747.30	103,399,996.15	108,322,816.48
归属于上市公司股东的净利润	7,068,533.01	18,668,102.25	8,327,826.98	9,011,409.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,411,727.88	17,443,165.92	7,226,493.82	7,570,536.59
经营活动产生的现金流量净额	12,603,204.48	4,033,639.31	12,526,928.69	22,282,998.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,568	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,113	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
徐一俊	境内自然人	23.59%	30,572,290.00	24,867,472.00	质押	7,320,000.00	
徐伟	境内自然人	12.00%	15,548,000.00	0.00	不适用	0.00	
隆基绿能科技股份有限公司	境内非国有法人	6.04%	7,826,000.00	0.00	不适用	0.00	
黄笑容	境内自然人	2.53%	3,285,262.00	3,285,262.00	不适用	0.00	
郭兵健	境内自然人	2.35%	3,040,021.00	2,557,841.00	不适用	0.00	
李志萍	境内自然人	2.15%	2,780,700.00	2,079,025.00	不适用	0.00	
广发证券股份有限公司—国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71%	915,801.00	0.00	不适用	0.00	
中国工商银行股份有限公司—大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金	其他	0.40%	518,250.00	0.00	不适用	0.00	
蔡午	境内自然人	0.39%	505,800.00	0.00	不适用	0.00	
高盛国际—自有资金	境外法人	0.35%	451,173.00	0.00	不适用	0.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐一俊、徐伟系兄弟关系，且是一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

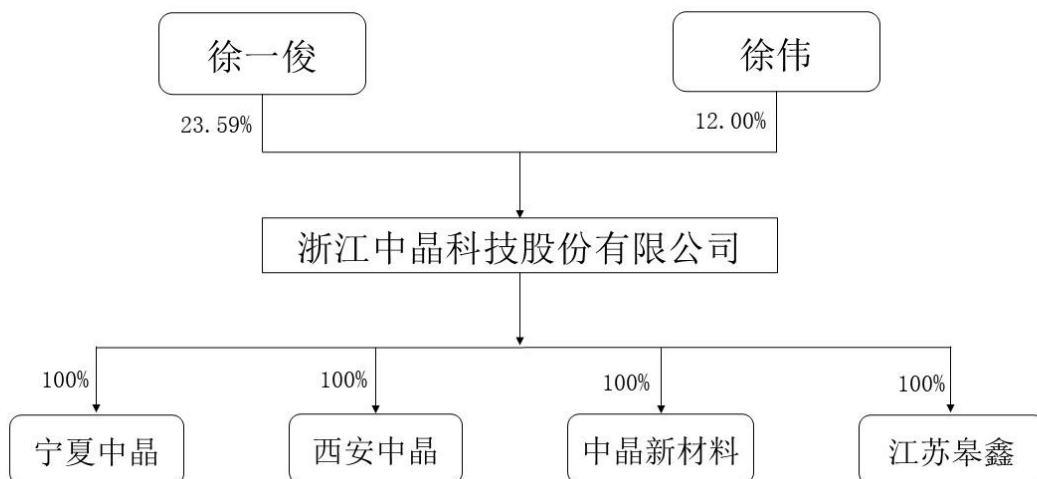
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

无。